

2020-2026年中国集成电路 行业分析与市场年度调研报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国集成电路行业分析与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202008/180343.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它在电路中用字母“IC”表示。集成电路发明者为杰克·基尔比（基于锗（Ge）的集成电路）和罗伯特·诺伊思（基于硅（Si）的集成电路）。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路。2018年2-10月中国集成电路各月产量及同比增长走势

中企顾问网发布的《2020-2026年中国集成电路行业分析与市场年度调研报告》共八章。首先介绍了中国集成电路行业市场发展环境、集成电路整体运行态势等，接着分析了中国集成电路行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路市场竞争格局。随后，报告对集成电路做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国集成电路行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资中国集成电路行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：中国集成电路行业发展分析

1.1 集成电路行业发展综述

1.1.1 集成电路的定义

1.1.2 集成电路行业周期性

1.1.3 集成电路产业链简介

1.1.4 集成电路材料设备供给分析

（1）晶圆材料供给分析

（2）封测设备供给分析

1.1.5 集成电路行业发展环境分析

（1）集成电路行业政策环境分析

（2）集成电路行业经济环境分析

(3) 集成电路行业技术环境分析

(4) 集成电路行业进出口环境分析

1.2 集成电路行业发展分析

1.2.1 集成电路产业发展现状分析

(1) 行业发展势头良好

(2) 行业技术水平快速提升

(3) 行业竞争力仍有待加强

(4) 产业结构进一步优化

1.2.2 集成电路产业区域发展格局分析

(1) 三大区域集聚发展格局业已形成

(2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征

(3) 产业整体将“有聚有分，东进西移”

1.2.3 集成电路产业面临的发展机遇

(1) 产业政策环境进一步向好

(2) 战略性新兴产业将加速发展

(3) 资本市场将为企业融资提供更多机会

1.2.4 集成电路产业面临的主要问题

(1) 规模小，依赖进口

(2) 投资规模不足

(3) 创新力度不够

(4) 价值链整合不够

(5) 产业链不完善

1.3 集成电路设计业发展分析

1.3.1 集成电路设计业发展概况分析

1.3.2 集成电路设计业市场规模分析

1.3.3 集成电路设计业市场特征分析

(1) 技术能力大幅提升

(2) 资本运作日益频繁

(3) 行业发展仍存隐忧

1.3.4 集成电路设计业竞争格局分析

1.3.5 集成电路设计业发展策略分析

1.3.6 集成电路设计业发展前景预测

1.4 集成电路制造所属行业发展分析

1.4.1 集成电路制造业发展现状分析

- (1) 集成电路制造业发展总体概况
- (2) 集成电路制造业发展主要特点
- (3) 集成电路制造业规模及财务指标分析

1.4.2 集成电路制造业经济指标分析

- (1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素
- (2) 集成电路制造业经济指标分析
- (3) 不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析
- (4) 不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析
- (5) 不同地区企业经济指标分析

1.4.3 集成电路制造业供需平衡分析

- (1) 全国集成电路制造业供给情况分析2010-2018年中国集成电路行业产量及增长走势
- (2) 全国集成电路制造业需求情况分析
- (3) 全国集成电路制造业产销率分析

1.4.4 集成电路制造业发展前景预测

1.5 集成电路封装测试业发展分析

1.5.1 集成电路封测业市场规模分析

1.5.2 集成电路封测业经营情况分析

1.5.3 国内外厂商技术水平对比分析

1.5.4 集成电路封测业竞争格局分析

- (1) 国内集成电路封测行业竞争格局分析
- (2) 中国集成电路封测企业国际竞争力分析
- (3) 行业竞争结构波特五力模型分析

1.5.5 集成电路封测业发展趋势分析

- (1) 封装技术发展趋势
- (2) 应用领域发展趋势

1.5.6 集成电路封测业发展前景预测

第2章：中国集成电路细分产品市场需求分析

2.1 IC卡市场需求分析

2.1.1 IC卡市场需求现状分析

2.1.2 IC卡市场需求规模分析

2.1.3 IC卡市场竞争格局分析

2.1.4 IC卡市场需求前景预测

2.2 计算机市场需求分析

2.2.1 计算机市场需求现状分析

2.2.2 计算机市场投资规模分析

2.2.3 计算机市场需求规模分析

2.2.4 计算机市场经营效益分析

2.2.5 计算机市场竞争格局分析

(1) 一体电脑市场竞争格局

(2) 笔记本市场竞争格局

(3) 平板电脑市场竞争格局

(4) 超极本市场竞争格局

2.2.6 计算机市场发展趋势预测

2.3 通信设备市场需求分析

2.3.1 通信设备市场需求现状分析

2.3.2 通信设备市场需求规模分析

2.3.3 通信设备市场竞争格局分析

(1) 手机市场竞争格局

(2) 智能手机市场竞争格局

2.3.4 通信设备市场需求前景预测

2.4 消费电子市场需求分析

2.4.1 消费电子市场需求现状分析

2.4.2 消费电子市场需求规模分析

2.4.3 消费电子市场竞争格局分析

(1) U盘市场竞争格局

(2) 闪存卡市场竞争格局

(3) 移动硬盘市场竞争格局

2.5 MCU市场需求分析

2.5.1 MCU市场需求现状分析

2.5.2 MCU市场需求规模分析

2.5.3 MCU市场竞争格局分析

(1) MCU市场整体竞争格局

(2) MCU细分市场竞争格局

2.5.4 MCU市场需求前景预测

(1) MCU市场整体需求预测

(2) MCU主要应用领域需求预测

第3章：芯片市场需求分析

3.1 LED芯片市场需求分析

3.1.1 LED芯片发展现状分析

(1) LED芯片供求现状

(2) LED芯片价格现状

3.1.2 LED芯片需求规模分析

3.1.3 LED芯片竞争格局分析

(1) 区域竞争分析

(2) 市场占有率分析

(3) 竞争力分析

(4) LED芯片品牌总汇

(5) 国外LED芯片厂商介绍

(6) 全球LED芯片三大阵营市场研究

3.1.4 LED芯片需求前景预测

3.2 SIM芯片市场需求分析

3.2.1 SIM芯片发展现状分析

3.2.2 SIM芯片需求规模分析

3.2.3 SIM芯片竞争格局分析

3.2.4 SIM芯片需求前景预测

3.3 身份识别类芯片市场需求分析

3.3.1 身份识别类芯片发展现状分析

3.3.2 身份识别类芯片需求规模分析

3.3.3 身份识别类芯片竞争格局分析

3.3.4 身份识别类芯片需求前景预测

3.4 金融支付类芯片市场需求分析

3.4.1 金融支付类芯片发展现状分析

3.4.2 金融支付类芯片需求规模分析

3.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析

3.4.4 金融支付类芯片需求前景预测

3.5 银行IC卡芯片市场需求分析

3.5.1 银行IC卡芯片发展现状分析

3.5.2 银行IC卡芯片需求规模分析

3.5.3 银行IC卡芯片竞争格局分析

3.5.4 银行IC卡芯片需求前景预测

3.6 居民健康卡芯片市场需求分析

3.6.1 居民健康卡芯片发展现状分析

3.6.2 居民健康卡芯片需求规模分析

3.6.3 居民健康卡芯片竞争格局分析

3.6.4 居民健康卡芯片需求前景预测

3.7 社保卡芯片市场需求分析

3.7.1 社保卡芯片发展现状分析

3.7.2 社保卡芯片需求规模分析

3.7.3 社保卡芯片竞争格局分析

3.7.4 社保卡芯片需求前景预测

3.8 移动支付芯片市场需求分析

3.8.1 移动支付芯片发展现状分析

(1) 移动支付产品分析

(2) 银联与中移动移动支付标准之争已经解决

(3) 2018年起三大运营商主推具有NFC功能的手机

(4) NFC移动支付不受央行新政限制

(5) 海外供应商垄断NFC芯片

3.8.2 移动支付芯片需求规模分析

3.8.3 移动支付芯片竞争格局分析

3.8.4 移动支付芯片需求前景预测

3.9 USB-KEY芯片市场需求分析

3.9.1 USB-KEY芯片发展现状分析

3.9.2 USB-KEY芯片需求规模分析

3.9.3 USB-KEY芯片竞争格局分析

3.9.4 USB-KEY芯片需求前景预测

3.10 TD-LTE芯片市场需求分析

- 3.10.1 TD-LTE芯片发展现状分析
- 3.10.2 TD-LTE芯片需求规模分析
- 3.10.3 TD-LTE芯片竞争格局分析
- 3.10.4 TD-LTE芯片需求前景预测
- 3.11 安全芯片市场需求分析
 - 3.11.1 安全芯片发展现状分析
 - 3.11.2 安全芯片需求规模分析
 - 3.11.3 安全芯片竞争格局分析
 - 3.11.4 安全芯片需求前景预测
- 3.12 通讯射频芯片市场需求分析
 - 3.12.1 通讯射频芯片发展现状分析
 - 3.12.2 通讯射频芯片需求规模分析
 - 3.12.3 通讯射频芯片竞争格局分析
 - 3.12.4 通讯射频芯片需求前景预测
- 3.13 家电控制芯片市场需求分析
 - 3.13.1 家电控制芯片发展现状分析
 - 3.13.2 小家电控制芯片需求规模分析
 - 3.13.3 家电控制芯片竞争格局分析
 - 3.13.4 小家电控制芯片需求前景预测
- 3.14 节能应用类芯片市场需求分析
 - 3.14.1 节能应用类芯片发展现状分析
 - 3.14.2 节能应用类芯片需求规模分析
 - 3.14.3 节能应用类芯片竞争格局分析
 - 3.14.4 节能应用类芯片需求前景预测
- 3.15 电脑数码类芯片市场需求分析
 - 3.15.1 电脑数码类芯片发展现状分析
 - 3.15.2 电脑数码类芯片需求规模分析
 - 3.15.3 电脑数码类芯片竞争格局分析
 - 3.15.4 电脑数码类芯片需求前景预测
- 3.16 电源管理芯片市场需求分析
 - 3.16.1 电源管理芯片发展现状分析
 - 3.16.2 电源管理芯片需求规模分析

3.16.3 电源管理芯片竞争格局分析

3.16.4 电源管理芯片需求前景预测

3.17 分立器件芯片市场需求分析

3.17.1 分立器件芯片发展现状分析

3.17.2 分立器件芯片需求规模分析

3.17.3 分立器件芯片竞争格局分析

3.17.4 分立器件芯片需求前景预测

第4章：中国集成电路下游市场需求分析

4.1 计算机行业对集成电路需求分析

4.1.1 计算机行业发展现状分析

4.1.2 计算机对集成电路需求现状

4.1.3 计算机对集成电路需求前景

4.2 智能手机行业对集成电路需求分析

4.2.1 智能手机行业发展现状分析

4.2.2 智能手机对集成电路需求现状

4.2.3 智能手机对集成电路需求前景

4.3 平板电脑行业对集成电路需求分析

4.3.1 平板电脑行业发展现状分析

4.3.2 平板电脑对集成电路需求现状

4.3.3 平板电脑对集成电路需求前景

4.4 可穿戴设备行业对集成电路需求分析

4.4.1 可穿戴设备行业发展现状分析

4.4.2 可穿戴设备对集成电路需求现状

4.4.3 可穿戴设备对集成电路需求前景

4.5 工业控制行业对集成电路需求分析

4.5.1 工业控制行业发展现状分析

4.5.2 工业控制对集成电路需求现状

4.5.3 工业控制对集成电路需求前景

4.6 汽车电子行业对集成电路需求分析

4.6.1 汽车电子行业发展现状分析

4.6.2 汽车电子对集成电路需求现状

4.6.3 汽车电子对集成电路需求前景

第5章：主要集成电路行业竞争主体发展分析

5.1 外商独资企业发展分析

5.1.1 外商独资企业发展现状分析

5.1.2 外商独资企业市场份额分析

5.1.3 外商独资企业经营情况分析

5.1.4 外商独资企业投资并购分析

5.1.5 外商独资企业发展战略分析

5.1.6 外商独资企业竞争优势分析

5.1.7 外商独资企业最新动向分析

5.1.8 外商独资企业发展建议

5.2 中外合资企业发展分析

5.2.1 中外合资企业发展现状分析

5.2.2 中外合资企业市场份额分析

5.2.3 中外合资企业经营情况分析

5.2.4 中外合资企业投资并购分析

5.2.5 中外合资企业发展战略分析

5.2.6 中外合资企业竞争优势分析

5.2.7 中外合资企业存在问题分析

5.2.8 中外合资企业最新动向分析

5.2.9 中外合资企业发展建议

5.3 内资企业发展分析

5.3.1 内资企业发展现状分析

5.3.2 内资企业市场份额分析

5.3.3 内资企业经营情况分析

5.3.4 内资企业扶持政策分析

5.3.5 内资企业投资并购分析

5.3.6 内资企业发展战略分析

5.3.7 内资企业竞争优势分析

5.3.8 内资企业存在问题分析

5.3.9 内资企业最新动向分析

5.3.10 国内市场进口替代空间分析

5.3.11 内资企业发展建议

第6章：重点区域集成电路产业发展分析

6.1 长三角地区集成电路产业发展分析

6.1.1 集成电路产业发展概况

6.1.2 集成电路产业政策规划分析

6.1.3 集成电路产业发展现状分析

6.1.4 集成电路设计业发展分析

6.1.5 集成电路制造业发展分析

6.1.6 集成电路封装测试业发展分析

6.1.7 集成电路产业发展前景预测

6.2 京津环渤海地区集成电路产业发展分析

6.2.1 集成电路产业发展概况

6.2.2 集成电路产业政策规划分析

6.2.3 集成电路产业发展现状分析

6.2.4 集成电路设计业发展分析

6.2.5 集成电路制造业发展分析

6.2.6 集成电路封装测试业发展分析

6.2.7 集成电路产业发展前景预测

6.3 泛珠三角地区集成电路产业发展分析

6.3.1 集成电路产业发展概况

6.3.2 集成电路产业政策规划分析

6.3.3 集成电路产业配套发展分析

6.3.4 集成电路产业发展现状分析

6.3.5 集成电路设计业发展分析

6.3.6 集成电路制造业发展分析

6.3.7 集成电路封装测试业发展分析

6.3.8 集成电路产业发展前景预测

6.4 其他重点地区集成电路产业发展分析

6.4.1 重庆市集成电路产业发展分析

6.4.2 成都市集成电路产业发展分析

6.4.3 西安市集成电路产业发展分析

6.4.4 武汉市集成电路产业发展分析

第7章：集成电路领先企业发展分析

7.1 集成电路设计企业发展分析

7.1.1 炬力集成电路设计有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.2 中国华大集成电路设计集团有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.3 北京中星微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.4 大唐微电子技术有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.5 深圳海思半导体有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.6 无锡华润矽科微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.7 杭州士兰集成电路有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.8 上海华虹集成电路有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.9 北京同方微电子有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.1.10 展讯通信（上海）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.2 集成电路制造企业发展分析

7.2.1 中芯国际集成电路制造有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.2.2 上海华虹（集团）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业营销网络分析

7.2.3 华润微电子（控股）有限公司

- (1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

7.2.4 无锡海力士意法半导体有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

7.2.5 和舰科技(苏州)有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

7.2.6 江苏长电科技股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

7.2.7 上海先进半导体制造股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

7.2.8 台积电(上海)有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

7.2.9 上海华虹宏力半导体制造有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

7.2.10 吉林华微电子股份有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业营销网络分析

7.3 集成电路封装测试企业发展分析

7.3.1 飞思卡尔半导体(中国)有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

7.3.2 南通华达微电子集团有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

7.3.3 日月光封装测试(上海)有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

7.3.4 深圳赛意法微电子有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

7.3.5 江苏新潮科技集团有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业产品结构分析

(4) 企业技术水平分析

7.3.6 上海松下半导体有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析

7.3.7 英特尔产品（成都）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析

7.3.8 南通富士通微电子股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析

7.3.9 星科金朋（上海）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析

7.3.10 乐山无线电股份有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业产品结构分析
- (4) 企业技术水平分析

第8章：行业发展趋势与前景预测

8.1 集成电路行业发展趋势分析

8.1.1 集成电路行业区域发展趋势

8.1.2 集成电路行业技术发展趋势

8.1.3 集成电路行业产品结构趋势

8.1.4 集成电路行业市场竞争趋势

8.2 集成电路行业市场前景预测

8.2.1 集成电路行业市场规模预测

8.2.2 集成电路企业经营前景预测

8.3 集成电路行业投资前景预测

8.3.1 集成电路行业进入壁垒分析

8.3.2 集成电路行业投资风险分析

8.3.3 集成电路行业投资可行性分析

8.3.4 集成电路行业投资前景分析

8.4 中咨集成电路行业投资建议

8.4.1 集成电路细分市场投资建议

8.4.2 集成电路区域布局投资建议

8.4.3 集成电路企业并购重组建议

图表目录：

图表：集成电路产业链示意图

图表：全球前十大12英寸晶圆产能供货商（单位：千片/月，%）

图表：2020-2026年我国电子专用设备制造业发展规模（单位：亿元，%）

图表：通过验收的29项封测设备

图表：集成电路行业主要政策分析

图表：2009-2018年中国国内生产总值及其增长情况（单位：亿元，%）

图表：2009-2018年全国工业增加值及其增长情况（单位：亿元，%）

图表：2018年我国主要宏观经济指标增长率预测（单位：%）

图表：2009-2018年中国GDP增速与集成电路行业销售额增速对比图（单位：%）

图表：1993-2018年集成电路行业相关专利申请数量变化图（单位：项）

图表：1993-2018年集成电路行业相关专利公开数量变化图（单位：项）

图表：截至2018年30日中国集成电路行业相关专利申请类型（单位：%）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202008/180343.html>